

H6039 有机硅电子灌封胶

H6039 液体硅胶,具有优异的流动性,操作方便;固化温度低,硫化速度快,耐高低温性好,电绝缘性能优异;固化后硅胶片柔软,粘性好。产品在电子电气行业中广泛用于制作绝缘、密封、散热材料等。作为导热基料使用时,客户可灵活添加各种导热填料制成不同导热系数的导热硅胶系列产品。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	硅胶
外观	乳白色液体
组分	双组分
固化方式	室温或加温固化
应用	粘接

产品优点

- 优异的流动性;
- 操作方便;
- 固化温度低;
- 硫化速度快;
- 耐高低温性好;
- 电绝缘性能优异;
- 固化后硅胶片柔软,粘性好。

产品应用

H6039 加成型液体硅胶可用于制作高阻燃硅胶、高回弹导热硅胶、导热硅胶片基础油等。

产品性能

未固化时性能

条目	H6039A	Н6039В	备注
外观	乳白色液体	乳白色液体	/



粘 cps	度	3,000	3, 500	@25℃
密度/比重	$\mathrm{g/cm^3}$	0. 97		@25℃
混合比		A:B=1:1		重量比
凝胶时间		30 分钟		@25℃

固化条件

条目	典型值	备注
常温固化	8h	@25℃
热固化	30min	@80°C
热固化	15 min	@120℃

固化后性能:

条目			典型值	备注
物理性能	硬度 00	Shore	22	GB/T 2411
	拉伸强度	MPa	1.5	GB/T 528
	拉伸率	%	450	GB/T 528
	撕裂强度	KN/m	3	GB/T 529
	体积电阻率	Ω.cm	1.0×10^{10}	ASTM D257

操作指南

- 1. 计量:准确称量 A、B组份混料称重误差小于 0.1%,否则会影响固化。
- 2. 脱泡: A、B 组分可自然脱泡和真空脱泡,自然脱泡:将搅拌完的胶静置 20-30 分钟;真空脱泡:真空度为 0.09-0.1MPa,抽 3-5 分钟。
- 3. 混胶: A、B组分用静态混合器混合,直接点胶。

注意事项

- 1. 不要接触 N、P、S 等有机物, Sn、Pb、HgBAs 等离子化合物。
- 2. 勿入口眼,不慎溅入的话,用大量清水进行冲洗。

标准包装

● 1kg/罐, 20kg/桶



● 根据客户需要

产品储存

本产品无毒性、无危险性,遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内,并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件: 25℃,储存期 12 个月。

为防止未使用产品受到污染,请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件 下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息,请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注:本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外,及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题,包括针对某一特殊用途的适用性问题,我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。



湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com